

기술 2024-158

2024.09.26.

이 보고서는 시가총액 5,000억 원 미만의 중소형 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서 화학

# 와이엠티(251370)

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

작성기관 한국기술신용평가(주) 작성자 류지원 전문연구원

[YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브(IRTV)로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 "한국IR협의회" 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-525-7759)로 연락하여 주시기 바랍니다.

## 와이엠티(251370)

## PCB 및 반도체패키지 화학소재 전문기업

## 기업정보(2024.09.19. 기준)

대표자	전성욱, 백성규
설립일자	1999년 02월 11일
상장일자	2017년 04월 27일
기업규모	중소기업
업종분류	기초 화학물질 제조업
주요제품	FPCB 금도금 화학소재 등

## 시세정보(2024.09.19. 기준)

현재가(원)	9,000
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	1,468
발행주식수(주)	16,314,464
52주 최고가(원)	14,400
52주 최저가(원)	7,350
외국인지분율(%)	1.44
주요주주(%)	
전성욱	31.38
타이탄(주)	5.19

## ■ PCB 및 반도체패키지 공정용 화학소재 전문기업

와이엠티(이하 ‘동사’)는 1992년 2월 설립된 PCB 및 반도체패키지 화학소재 전문기업으로 2017년 4월 코스닥시장에 상장하였다. 사업의 확장과 신규사업으로의 진출을 위해 중국과 베트남에 해외법인을 설립하였고, 종속회사로 화학제품 및 원소재를 유통하는 (주)키미랩, 기관가공 사업을 영위하는 와이피티(주), 도금기계 제조 사업을 영위하는 비온드솔루션(주)을 편입하였다.

## ■ ICT 산업의 발전과 전자기기 시장의 확대에 따른 수혜 기대

한국PCB&반도체패키지산업협회(KPCA)에 따르면, 세계 PCB 시장규모는 2023년 9,307,000백만 엔이며, 2028년 예상되는 시장규모는 11,047,400백만 엔으로 조사되는 바 글로벌 PCB 산업의 시장이 성장할 것으로 전망하고 있다. 또한, 전방산업인 ICT 산업의 발전과 전자기기, 5G, 반도체 시장의 성장에 따라 PCB 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 전자제품의 소형화 및 경량화 추세로 FPCB 시장이 확대됨에 따라 PCB 화학소재 시장의 동반성장이 기대된다.

## ■ 화학약품 사업에서 소재 및 장비 사업으로의 확장을 통한 성장동력 확보

동사는 화학약품 사업의 기술적 차별화와 PCB 시장에서 요구하는 고신뢰성, 고내구성 특성을 갖는 제품개발을 위해 기존 화학약품 사업에서 화학/전자소재 및 PCB 장비 사업으로 확장하고 있다. 동사는 고객사별 맞춤형 화학약품과 장비를 개발하고 있으며, 유지보수 서비스를 제공하고 있고, 신규사업 아이템 발굴과 지속적인 연구로 시장 내 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있다.

## 요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2021	1,256	10.6	172	13.7	140	11.2	9.1	6.3	76.7	648	7,569	34.9	3.0
2022	1,306	4.0	33	2.6	26	2.0	0.0	1.1	63.8	-3	7,667	N/A	1.8
2023	1,274	-2.4	-32	-2.5	-1	-0.1	-2.3	0.0	68.6	-177	7,530	N/A	1.4

### 기업경쟁력

#### 글로벌 네트워크 확보

- 대만, 중국으로의 진출을 통해 안정적인 판매 체계를 구축하고 있으며, 중국에는 판매법인, 대만에는 지사를 설립하였음.
- 중국 시장에는 에이전트를 통한 영업이 아닌 판매법인을 통한 시장 진출로 현지 엔지니어 인력을 다수 보유하고 있는 바 중국 시장 내 높은 기술경쟁력을 확보하고 있음.

#### 우수한 연구개발 역량 확보

- 전동개발팀, 화학동개발팀, 회로약품개발팀, 표면처리개발팀, 전락개발팀, 분석팀, 연구기획팀으로 조직된 연구소를 운영하고 있으며, 박사 3인, 석사 13인, 학사 9인 등으로 구성되어 있음.
- 2010년부터 꾸준히 국가연구개발 사업에 참여하고 있으며, 2023년 기준 국책과제 2건 (중소벤처기업부 1건, 과학기술정보통신부 1건) 수행 실적을 보유하고 있고, 총 68건의 국내 등록 특허권을 보유하고 있음.

### 핵심 기술 및 적용제품

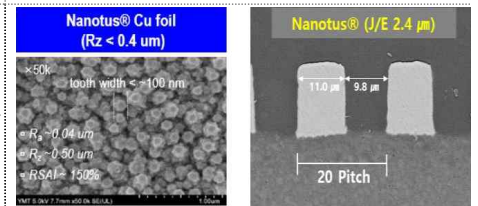
#### PCB 표면처리 분야

- Soft ENIG(Soft Electroless Nickel Immersion Gold) 표면처리 기술: FPCB(Flexible PCB)에 물리적인 힘이 가해져도 회로가 단선되지 않도록 수행하는 표면처리 기술, 우수한 내절곡성과 젖음성 특성, 친환경 소재 사용으로 경쟁력 확보
- ENEPIG(Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold) 표면처리 기술: 반도체패키지 기판, 카메라 모듈에 적용되는 표면처리 기술, 회로 디자인의 자유도 보장, 경박단소화, 도금 번짐 방지로 경쟁력 확보
- 무전해화합동도금 기술: 다층기판 제조 시 각 층을 전기적으로 연결하기 위해 구리층을 형성하는 기술, 도금액의 안정성과 수지와의 밀착력 향상을 위한 특수 안정제, 특수 첨가제를 개발로 경쟁력 확보



#### 전자재료 분야

- 극동박(Ultra-thin Copper Foil) 소재 기술: 반도체 PCB의 원소재로 높은 에칭 속도, 균일한 두께 편차, 낮은 표면 조도, 광범위한 제품 활용도로 경쟁력 확보



### 시장경쟁력

#### 글로벌 고객사와의 거래

- 동사의 제품은 국내/외 정상급 제조사의 스마트폰, 태블릿 PC 등 다양한 전자기기에 적용되고 있음.
- 우수한 기술력과 양산 능력 확보, 엄격한 공정 실사를 통과하였으며, 정상급의 고객사 공급 이력을 바탕으로 다방면으로의 영업을 확대하고 있음.

#### 우수한 고객사 대응력

- 업계 특성상 기판 구성에 따른 화학소재의 구성이 다르고, 지속적인 유지보수가 중요함. 이에 따라, 동사는 다수의 엔지니어를 확보하고 있으며, 고객사 요구사항에 따른 설비와 화학소재 제조 및 유지보수 서비스를 제공하고 있음.



## I. 기업 현황

### 혁신 기술을 선도하는 PCB 및 반도체 기판 전자 소재 전문기업

동사는 PCB(인쇄회로기판) 및 반도체패키지 기판에 사용되는 화학약품과 전자재료를 제조 및 공급하는 전자 화학소재 전문기업이다. 주요 제품으로는 최종표면처리, 동도금, 공정약품 등이 있으며, 최근에는 차세대 반도체와 디스플레이용 신소재 개발 분야를 강화하고 있다. 특히 극동박과 TGV(Through Glass Via) 사업 등 제품 포트폴리오를 확장하며 성장 동력을 확보하고 있다.

### ■ 회사의 개요

동사는 전자공업약품 및 금속표면처리 약품의 제조 및 판매를 목적으로 1999년 2월 유일재료기술로 설립되었으며, 본사는 인천광역시 남동구 남동동로153번길 30에 위치하고 있다. 2006년 7월 상호를 와이엠티(주)로 변경하였으며, 2017년 4월 코스닥시장에 상장했다. 동사는 반도체패키지 기판용 초극박 소재 등 첨단 기술 분야에서의 국산화 및 기술혁신을 주도하며, 국내외 전자 화학소재 시장에서 입지를 넓혀가고 있다. 또한, 송도국제도시에 건설 중인 연구개발센터를 통해 전자부품 관련 신소재 개발을 중점으로 향후 기술 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 예정이다.

표 1. 동사 주요 연혁

일자	연혁 내용
1999.02	(주)유일재료기술 설립
2006.07	와이엠티(주)로 상호 변경
2006.09	Immersion Silver 화학소재 대만 수출
2007.02	PCB 도금 전문회사 와이피티(주) 자회사 설립
2009.01	Soft ENIG 중국 수출
2010.08	연간 수출 100만불 돌파
2010.08	ENEPIG 화학소재 수출 (Apple iphone기판 적용)
2011.03	Foxconn 화학소재 수출 개시
2011.10	ENEPIG용 무전해환원금도금 화학소재 수출
2012.11	국내 제2공장 설립(남동공단지점)
2012.12	수출 500만불탑 수상
2004.05	중국 법인 설립(YMT Shenzhen Co., Ltd.)
2015.09	베트남 법인 설립(YMT VINA Co., Ltd.)
2016.08	수평화학동도금 소재 베트남 수출
2017.04	코스닥시장 상장
2017.07	설비제조회사 비온드솔루션(주) 종속회사 편입
2019.06	베트남 법인 기판가공 공장 준공(베트남 빈푹공단)
2019.06	전자파 차폐소재(극동박) 공급 개시
2020.09	중국 Zhuhai 공장 착공(2024년 준공)
2020.10	소재·부품·장비 강소기업 100 선정(중소벤처기업부)
2021.06	마스크 등 의료·위생용품 제조·판매법인 (주)키미랩 설립
2021.06	화학제품 도매 회사 에스피머티리얼즈(주) 설립
2022.12	PKG PCB 기초소재 Nanotus 극동박 양산 개시
2023.06	송도국제도시 R&D센터 착공(2025년 1월 준공)

자료: 반기보고서(2024.06.) 및 동사 홈페이지

## 와이엠티(251370)

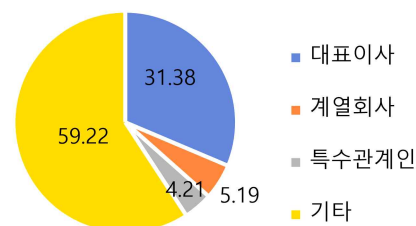
동사의 최대주주는 전성욱 대표이사로 31.38%의 지분을 보유 중이며, 계열회사 타이탄(주)는 5.19%를 보유, 전성욱 외 4인의 특수관계인이 4.21%의 지분을 보유하고 있다.

표 2. 동사 지분구조 현황

주주명	관계	주식수(주)	지분율(%)
전성욱	대표이사	5,120,000	31.38
타이탄(주)	계열회사	846,391	5.19
전성욱 외 4인	특수관계인	686,197	4.21
기타	-	9,661,876	59.22
합계		16,314,464	100.00

자료: 반기보고서(2024.06.)

그림 1. 동사 지분구조 현황



자료: 반기보고서(2024.06.)

동사는 2024년 반기 기준, 5개의 종속회사를 보유하고 있다. PCB 등 도금 처리 공정업체인 와이피티(주)와 해외 현지 판매법인 YMT Shenzhen Co., Ltd., YMT VINA Co., Ltd.를 종속회사로 두고 있으며, 비온드솔루션(주)은 도금 기계 제조 및 도소매업을 주요 사업으로 하고 있다. 키미랩(주)은 화학제품 및 기초 원소재 등의 수출입 유통판매 및 마스크제품 판매 사업을 병행하여 진행하고 있다.

표 3. 동사 종속회사 현황

(단위 : 백만 원, 별도 기준)

상호	설립일	소재지	주요사업	최근 사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요 종속회사 여부
와이피티(주)	2007.02.22	경기도 안산시	PCB 동도금, 금도금 외주	18,223	의결권 과반수 보유	미해당
YMT Shenzhen Co., Ltd.	2012.12.23	Shenzhen, CHINA	PCB 화학소재 판매	55,085	의결권 과반수 보유	해당
YMT VINA Co., Ltd.	2015.09.24	Vinh Phuc Province, Vietnam	PCB 화학소재 판매	27,873	의결권 과반수 보유	해당
비온드솔루션(주)	2016.05.17	경기도 안산시	도금기계 제조 및 도소매	4,724	의결권 과반수 보유	미해당
키미랩(주)	2021.06.01	경기도 안산시	의료용품 제조/판매 및 화학제품 도매업	1,507	의결권 과반수 보유	미해당

자료: 반기보고서(2024.06.)

### ■ 대표이사

전성욱 대표이사는 인하대학교 금속공학을 전공하였으며, 한국하우톤(주)의 표면처리사업부에서 경력을 쌓은 후, 1999년 2월 동사를 설립하여 현재까지 회사를 이끌며 전사 경영을 총괄하고 있다. PCB 및 반도체 분야에서 무전해 니켈 도금 기술을 독자적으로 개발했으며, 일본이 독점하던 극동박 시장에 도전하여 세계 최초로 나노투스 극동박을 개발하는 등 기술혁신을 주도하며 글로벌 선도 기업으로의 성장을 이끌고 있다.

백성규 대표이사는 인천대학교 행정학을 전공했으며, 2024년 1월, 전성욱 대표와 함께 각자 대표이사로 선임되었다. 2006년 10월부터 동사의 영업부문장과 사업 총괄이사를 역임하며, 다양한 영업 전략을 통해 영업망을 확장하고 시장에서의 성장을 주도한 영업 전문가이다.

■ 주요 사업 분야 및 부문별 매출실적

표 4. 주요 사업부문

부문	주요 사업 내용
화학약품 사업부문	금·동도금약품, 공정약품의 생산
기판가공 사업부문	금·동도금기판의 가공처리
전자재료 사업부문	극동박(Ultra-thin Copper Foil) 소재 기술 등
설비제조 사업부문	장비의 제조 및 수리
소재유통 사업부문	화학·직물제품의 유통

자료: 반기보고서(2024.06.)

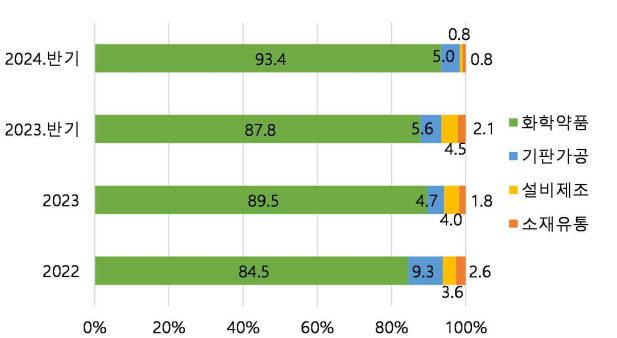
동사는 전자공업약품 및 금속표면처리 약품의 제조 및 판매 사업을 주력으로 영위하고 있으며, 주요 사업 부문은 크게 화학약품, 기판가공, 전자재료, 설비제조 및 소재 유통으로 나눌 수 있다. 화학약품 부문은 2024년 반기 매출액 기준, 93.4%의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, PCB 및 반도체 패키지 기판에 필수적으로 사용되는 최종표면처리, 동도금, 공정약품 등을 포함하고 있다. 기판가공 부문은 FPCB(연성 인쇄회로기판)을 중심으로 고객 맞춤형 가공 서비스를 제공하고 있으며, 반기 매출액 기준 5.0%의 매출 비중을 나타내고 있다. 동사의 새로운 성장 동력인 전자재료 부문은 고사양 전자제품에 사용되는 극동박 등이 있으며, 설비제조 부문은 자회사 비온드솔루션(주)를 통해 PCB 제조 장비를 제작, 소재유통 부문에서는 기판 및 전자부품 생산에 필요한 다양한 소재를 국내외 시장에 공급하고 있다.

표 5. 부문별 매출실적 (단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

사업부문	2022	2023	2023. 반기	2024. 반기
화학약품	1,360	1,418	610	703
기판가공	150	74	39	38
설비제조	58	64	31	6
소재유통	42	28	15	6
(연결조정)	(304)	(310)	(121)	(110)
합계	1,306	1,274	574	643

자료: 동사 반기보고서(2024.06.), 한국기술신용평가 재구성

그림 2. 부문별 매출비중 (단위: %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 반기보고서(2024.06.)

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

E

환경경영

- ◎ 화학물질을 다루는 사업장으로 '유해 화학 물질 제조업 허가증', '유해 화학 물질 사용업 허가증', '대기 배출 시설 설치 허가증', '폐수/악취 배출 시설 설치 신고 필증' 등 환경 및 안전 관련 허가/신고를 완료하였음.
- ◎ 인천광역시청으로부터 자율점검 업소로 지정되었으며, 2016년 환경관리 우수업체로 선정되어, 한강유역 환경 청장 표창장을 수여 받은 이력이 있음.
- ◎ ISO 14001 인증을 취득하였으며, 전 직원을 대상으로 연간 2회씩 정기 교육을 시행하고 있음.

S

사회책임경영

- ◎ 안전한 근로환경 구축을 위해 안전환경관리감독을 시행하고 있으며, 2025년 송도 연구센터 준공 후 해당 신 사옥으로 이전 예정임.
- ◎ ISO 9001 인증을 취득하였으며, 해당 인증을 기반으로 품질경영 매뉴얼과 방침을 제정하여 실천하고 있음.

G

기업지배구조

- ◎ 당사는 이사회 내 별도의 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으나, 상근 감사위원 1명이 감사업무를 수행 하고 있음.
- ◎ 당사는 경영정보 공개를 관련 법규 및 사규에 따라 투명하게 진행되고 있으며, 투자자 보호를 위해 감사보고 서, 사업보고서 외 필요한 사항(공시 내용 진행 및 변경 사항, 경영 사항) 등을 대외적으로 공개하여 기업공시 제도 의무를 준수하고 있음.

## II. 시장 동향

### ICT 산업의 발전과 전자기기 시장의 확대에 따른 성장 기대

동사가 참여하고 있는 PCB 화학소재 시장은 PCB 제조에 필수적인 공정약품으로 전방산업인 PCB 산업의 업황과 경기변동에 영향을 받는다. ICT 산업의 발전과 전자기기, 5G, 반도체 시장의 확대에 따라 PCB 산업이 성장하고 있으며, 전자제품의 소형화, 경량화, 고부가가치 제품의 수요 증가로 향후 PCB 화학소재 시장의 성장이 기대된다.

### ■ PCB 시장의 특징

동사는 PCB 제조 공정에 사용되는 다양한 화학소재를 개발 및 제조하는 기업으로 전방산업인 PCB 시장의 영향을 많이 받는다. PCB 시장은 모바일 및 웨어러블 기기 등 ICT 산업의 발전과 전자기기 시장의 확대, 전자제품의 소형화 및 경량화 추세 유지, 자동차, 방위 및 항공 등 광범위한 적용 분야로 지속적으로 수요가 증가할 것으로 전망된다. 또한, FPCB의 굴곡성, 배선 밀도, 조립의 용이성, 경박성 등 다양한 특성으로 인해 향후 적용 분야 및 범위가 확대될 것으로 예상된다.

또한, PCB가 많이 적용되는 전자기기의 기관, 카메라 모듈, 자동차 전장부품 등을 포함하는 전자부품 시장은 변화가 매우 빠르며, 제품의 성능 발전이 급진적인 편으로 완성품 제조업체의 제품개발 사이클에 대응할 수 있는 기술력, 인프라와 제품의 신뢰도를 요하는 바 시장진입장벽이 높다.

### ■ 국내 및 해외 PCB 시장현황 및 전망

한국PCB&반도체패키지산업협회(KPCA)의 조사에 따르면, 세계 PCB 시장규모는 2021년 7,901,100백만 엔이며, 꾸준히 증가하여 2028년에는 11,047,400백만 엔으로 전망하고 있다.

품목별 시장규모는 2022년 기준 다층 및 양단면 Rigid PCB가 43.2%, FPCB가 28.4%를 차지하였으며, Rigid PCB, HDI(High Density Interconnection), FPCB, PKG(반도체패키지) 품목 전반적으로 성장이 예상된다. 이러한 추세는 AI, 5G, 자동차, 반도체 등 전방산업 회복의 영향으로 조사된다. 국내 역시 이러한 성장에 힘입어 2023년 PCB 시장은 약 11조 484억 원으로 추산되며, 2024년에는 15조 2303억 원으로 확대될 것으로 전망된다.

표 6. 세계 PCB산업 품목별 시장규모

(단위: 백만엔, %)

품목	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
Rigid PCB	3,648,600	3,842,500	4,005,400	4,266,600	4,486,300	4,714,000	4,960,000	5,183,600
HDI	950,000	1,055,500	1,077,800	1,113,300	1,159,600	1,223,100	1,277,700	1,330,700
FPCB	2,100,000	2,530,000	2,620,000	2,700,000	2,775,000	2,850,000	2,910,000	2,950,000
PKG	1,202,500	1,466,100	1,603,800	1,778,400	1,955,900	2,116,600	2,150,800	1,583,100
합계	7,901,100	8,894,100	9,307,000	9,858,300	10,376,800	10,903,700	11,298,500	11,047,400
전년대비	-	112.6	104.6	105.9	105.3	105.1	104.5	104.0

자료: KPCA, PCB&반도체패키징 재료 동향(2023), 한국기술신용평가(주) 재구성



한국PCB&반도체패키지산업협회(KPCA)에 의하면, 동사가 직접적으로 참여하고 있는 시장인 금도금 및 동도금 화학소재 시장은 2022년 세라믹 기판, 메인 기판과 PCB 시장의 침체로 금도금, 동도금 시장규모가 감소하였다. 다만, 2023년 이후 PCB 시장의 회복과 함께 시장의 성장이 전망된다.

표 7. 세계 금도금 및 동도금 화학소재 시장규모

(단위: 톤)

종류	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
금도금 출하량	14,200	13,930	14,420	15,050	15,750	16,590	17,390	18,130
동도금 출하량	78,500	74,300	77,100	80,000	82,800	85,800	88,800	92,000

자료: KPCA, PCB&반도체패키징 재료 동향(2023), 한국기술신용평가(주) 재구성

## ■ 국내 PCB 관련 업계 현황

동사는 PCB 시장 내에서도 화학약품 및 소재 시장에 참여하고 있다. 현재 화학약품 및 소재 관련 기업은 동사를 포함하여 (주)케이피엠테크, (주)엠케이캠앤티, (주)오알캠, NR지엔씨가 있고, 해외기업으로는 UYEMURA, OKUNO, MKS, DuPont 등이 참여하고 있다.

표 8. 국내 PCB 화학소재 관련 주요 기업

기업명	사업 부문	기본정보 및 특징
(주)케이피엠테크	표면처리 관련 약품 사업, 기계 사업, 제약·바이오 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 코스닥 상장사, 중소기업</li> <li>- PCB 약품, 기능성도금 약품 및 일반장식 약품, PCB 도금장치, ABS 도금장치</li> <li>- KIPRIS(권리자번호: 119980988448) 검색 결과 등록 특허권 8건, 등록 디자인권 1건, 등록 상표권 4건을 보유하고 있음.</li> </ul>
(주)엠케이캠앤티	PCB, 반도체, 전자부품, 자동차, LED 등 표면처리 관련 약품 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 비상장사, 중소기업</li> <li>- 무전해니켈, 전해금도금, 무전해동도금, 전기동도금, OSP, 마이크로에칭, 전해니켈&amp;전해액도금 약품</li> <li>- KIPRIS(권리자번호: 120050438192) 검색 결과 등록 특허권 12건, 등록 상표권 10건을 보유하고 있음.</li> </ul>
(주)오알캠	PCB 공정약품 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 비상장사, 중소기업</li> <li>- Desmear, 무전해 화학동도금, Oxide 공정, DES 공정, 전처리 에칭액, 전기동도금, ENIG, EMI, 장비세정, 랙 박리용 약품</li> <li>- KIPRIS(권리자번호: 120090052957) 검색 결과 등록 특허권 9건, 등록 상표권 5건을 보유하고 있음.</li> </ul>
NR지엔씨	PCB 표면처리 약품 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 비상장사, 중소기업</li> <li>- 박리액, 에칭액, 도금 약품, 화학 연마액, 하프에칭액, 탈지액, 소포제, 현상액, 장비 세정액, 현상단 전용 세정액</li> </ul>

자료: 각 사 홈페이지, 분기보고서(2024) 특허정보검색서비스(KIPRIS), 한국기술신용평가(주) 재구성

### III. 기술분석

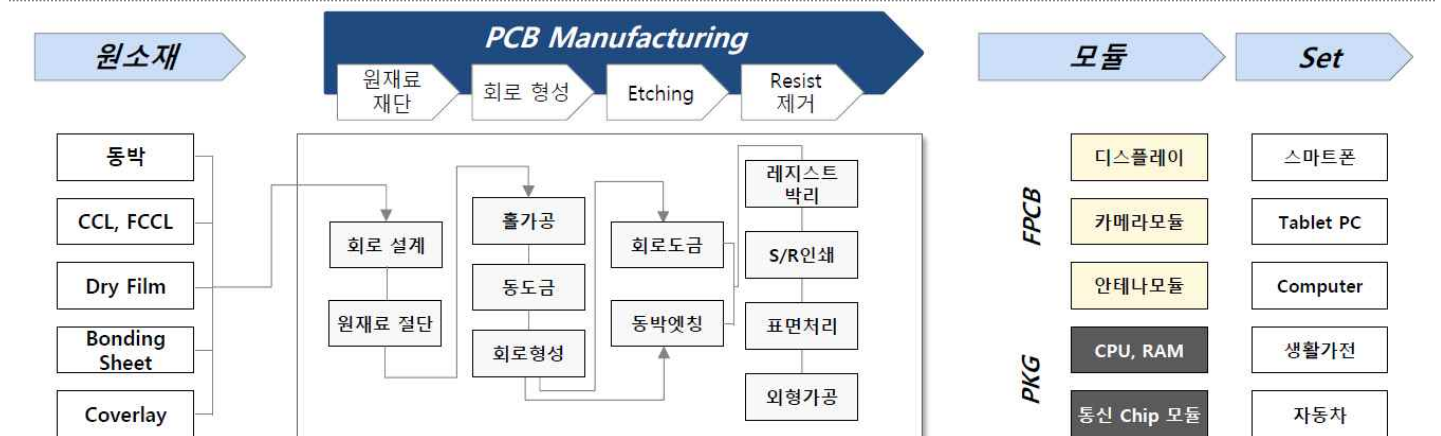
#### PCB 및 반도체패키지 화학소재 전문기업

동사는 화학약품 사업, 기판가공 사업, 설비제조 사업, 소재 유통 사업 등 PCB 제조와 관련된 다양한 사업을 영위하고 있다. 주력 제품은 최종표면처리 화학소재로 PCB 전 공정용 화학약품이며, 화학약품 기반 장비 사업으로의 확장과 CAPA 증설을 통해 안정적인 생산 규모를 확보하여 수익 증대를 기대하고 있다.

#### ■ 기술 및 제품 개요

동사의 주요 기술 및 제품으로는 ①화학약품 ②기판가공 ③설비제조 ④소재유통 ⑤전자재료 사업으로 분류되며, 화학약품, 전자재료 사업은 동사에서 수행하고 있으며, 기판가공, 설비제조, 소재유통 사업은 종속회사를 통해 수행하고 있다. 동사의 주요 사업은 화학약품 사업으로 PCB 회로부터 표면처리 등 PCB 제조 공정에 적용되는 약 248종의 화학약품을 보유하고 있다.

그림 3. 동사의 PCB 화학소재 산업 밸류체인



자료: 동사 IR자료(2024), 한국기술신용평가(주) 재구성

#### ■ 화학약품 사업

동사는 PCB 회로 형성, 도금, 에칭, 표면처리 등 PCB 제조 전 공정에 해당하는 다수의 화학약품을 취급하고 있다.

(가) 최종표면처리 화학소재: 기판, 부품의 산화를 방지하기 위해 피막을 입히는 공정

㉠ Soft ENIG(Soft Electroless Nickel Immersion Gold): 동사의 주력 제품으로 FPCB 표면처리에 사용되며, 무전해도금방식(무전해 니켈 도금 후 금 피막 형성)에 적용되고, FPCB가 휘어짐에 따라 표면처리된 도금도 같이 휘어지는 내절곡성 특성이 우수하다.

㉡ ENEPIG(Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold): 금 피막의 일부를 팔라듐으로 대체한 화학약품으로 원가절감이 가능하며, 접착 신뢰성이 향상되어 모듈성 부품에 적합하고, 향후 반도체패키지 시장으로의 진출을 계획하고 있다.

㉔ 그 외 최종표면처리: 무전해도금, 은도금, 주석도금 등에 해당하는 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 우수한 솔더링성, 굴곡성, 원가경쟁력을 기반으로 경쟁력을 확보하고 있다.

(나) 동도금 화학소재: 부도체 물질을 도체 물질로 가공하기 위해 동 소재를 입히는 공정

㉑ 무전해화학동도금: 다층 PCB 제조시에 시행하는 공정으로 각 층을 전기적으로 연결하기 위해 화학적인 방법을 통해 구리층을 형성하며, 안정성, 밀착력, 균일성이 우수하여 경쟁력을 확보하고 있다.

㉒ 전해동도금: 무전해화학동도금 후 수행하는 공정으로 광택제, 캐리어, 레벨러 등 다양한 첨가제를 사용하여 도금 특성을 부가하고, 적용 부위(PTH, Via-fill, Half-fill)의 종류에 따라 다양한 소재를 확보하고 있다.

(다) 공정약품: 세정, 에칭, 박리, 현상 등 전자부품(PCB, 반도체패키지, 반도체 등) 제조 공정에 사용되는 약품

㉑ 박리약품(DR Series): PCB의 회로 구현 공정에서 Dry Film을 박리하는 역할을 수행하는 약품으로 Dry Film의 종류와 설비에 따라 맞춤형으로 개발하고 있다.

㉒ 에칭약품(SE Series): PCB 표면 산화피막 제거와 미세조도 형성을 목적으로 사용하는 약품으로 표면 조도의 크기, 에칭 속도, 에칭률 등 다양한 조건에 따라 다양한 제품군을 보유하고 있다.

㉓ 금표면 활성화제(Gold Recover): 금도금 처리된 표면의 세정을 목적으로 개발되었으나 최근에는 웨이퍼 표면을 세정하는 용도로 사용되고 있다.

㉔ 탈지약품(Cleaner): 불순물, 산화층의 제거와 친수성 증가를 목적으로 사용하는 약품으로 PCB 제조에 가장 기초가 되는 공정 약품이다.

#### 그림 4. 동사 공정약품의 종류



자료: 동사 반기보고서(2024.08.), 한국기술신용평가(주) 재구성

## ■ 기관가공 사업

기관가공 사업은 종속회사인 와이피티에서 영위하고 있으며, 동사의 화학소재와 약품을 사용하여 전처리, 동도금, 금도금 등의 가공을 수행하고 있다.

## ■ 설비제조 사업

설비제조 사업은 종속회사인 비온드솔루션에서 영위하고 있으며, 도금 장비 제조를 주력으로 수행하고 있고, 와이엠티의 화학소재 및 약품과 호환성이 우수한 PCB 도금용 장비의 제작과 판매 및 장비 유지보수 서비스를 제공하고 있다.

## ■ PCB 관련 연구개발 역량

동사는 전기동개발팀, 화학동개발팀, 회로약품개발팀, 표면처리개발팀, 전략개발팀, 분석팀, 연구기획팀으로 구성된 기업부설연구소를 운영하고 있다.

- 전기동개발팀: 전기동도금, 기타 전기도금 개발
- 화학동개발팀: 무전해화학동도금, Conductive Coating 개발
- 회로약품개발팀: PCB 회로 공정약품, 반도체 약품, 장비 세정제 개발
- 표면처리개발팀: 무전해도금약품, Flux 세정제 개발
- 전략개발팀: 무전해화학동도금, 전기동도금 약품의 개선
- 분석팀: 개발 약품에 대한 전반적인 분석
- 연구기획팀: 특허, 국책과제, 연구소 관리

한편, 동사의 2024년 분기보고서상 연구개발비용은 2022년 4,637백만 원, 2023년 5,327백만 원으로 연구개발에 대한 꾸준한 투자가 이루어지고 있다. 동사는 신개념 동도금 첨가제 및 관련 도금 기술, 저조도 구리극동박, 팔라듐 도금 기술개발 등의 연구개발을 통해 PCB, 반도체패키지용 화학약품, 소재 및 기술을 개발하여 해외사에서 독점하고 있는 제품에 대한 국산화와 원천 기술을 확보하고자 한다.

표 9. 최근 3년 주요 국가연구개발 실적 현황

총 연구 기간	연구개발 과제명	기대효과
2021-09-01 ~ 2025-08-31	신개념 동도금 첨가제 기반 PKG/PCB용 인터커넥트(Via/TH/Pattern) 초균일/고속/일괄 도금 기술개발	PKG/PCB용 인터커넥트 초균일·고속·일괄 도금 기술확보: [HDI] 기존 Via-fill 후 Through hole 도금의 2회 공정에 대한 단일공정 대체 기술 개발, VH/TH 동시 도금에 대한 기술적 장벽 극복 / [PKG] 다양한 폭과 높이의 회로에 대한 균일 동도금 기술개발
2020-07-23 ~ 2023-12-31	5G 고속통신 FCCL용 저조도 구리극동박 제조 기술개발	저조도 극동박을 활용하여 5G 고속통신용 전자부품에 필수적인 저유전 FCCL 원천 소재 확보, 5G 전자부품의 핵심 기술인 신호전송 손실(signal transmission) 한계 극복 가능한 FCCL 공급으로 국내 5G 전자부품의 품질 향상 기대
2022-07-01 ~ 2023-06-30	2022년 디스플레이 소재부품장비 양산 성능평가 및 개선지원	수요 업체의 OLED TV 시장 성장 및 대면적화에 따른 제품 경량화 및 구조 단순화 등 차별화 기술 대응, 현재 L사 OLED TV에 독점 공급 중인 H사(일본)의 Invar 메탈 봉지재를 대체하여 국산화 및 핵심 원자재의 안정적인 국내 공급망 확보

자료: 동사 분기보고서(2024.08.) 국가과학기술지식정보서비스(NTIS), 한국기술평가(주) 재구성



#### IV. 재무분석

##### 2024년 상반기 주요사업인 화학약품 사업 부문의 실적 견인으로 매출액 증가하며 흑자전환

동사는 FPCB 및 반도체패키지 기판용 도금 소재 제조업체로, 2020년부터 반도체패키지 기판용 도금 소재, 전자재료(극동박, TGV 등)로 제품 포트폴리오를 확대해 왔다. 2023년 반도체패키지 기판용 화학약품 및 전자재료 매출 증가에도 불구하고, FPCB 업황 부진 및 주요 고객사 비수기 영향 등에 따라 매출액 감소 및 적자전환하였으나 2024년 상반기 화학약품 사업부문의 실적증가와 비용절감 노력으로 흑자전환에 성공하였다.

##### ■ 화학약품 사업부문의 성장세가 매출실적 견인

동사의 최근 3년간 실적을 살펴보면, 2021년 1,256억 원(+10.6%, yoy), 2022년 1,306억 원(+4.0%, yoy), 2023년 1,274억 원(-2.4%, yoy)의 매출액 기록하며 하향세를 나타내고 있다. 2023년 매출액 하락의 원인은 반도체패키지 기판용 화학약품 및 전자재료 매출이 증가했음에도 불구하고, FPCB 업황 부진 및 주요 고객사 비수기 등의 영향에 기인한다. 2023년 사업부문별 매출액은 화학약품(최종표면처리, 동도금, 공정약품) 1,418억 원(+4.3%, yoy), 기판가공 74억 원(-50.7%, yoy), 설비제조 64억 원(+10.3%, yoy), 소재유통 28억 원(-33.3%, yoy), 연결조정 -310억 원(+2.0%, yoy)으로 구성되며, 주요 사업부분인 화학약품 사업부분의 성장이 전체 매출액을 견인하고 있다.

한편, 2024년 상반기 매출액은 643억 원으로 스마트폰 수요 하향 안정화, 자동차 전장부품용 및 태블릿PC용 OLED용 수요 확대 등에 따른 동사의 전방산업인 F/RF-PCB 수요 회복 등의 영향으로 전년동기대비 12.1% 증가하였다.

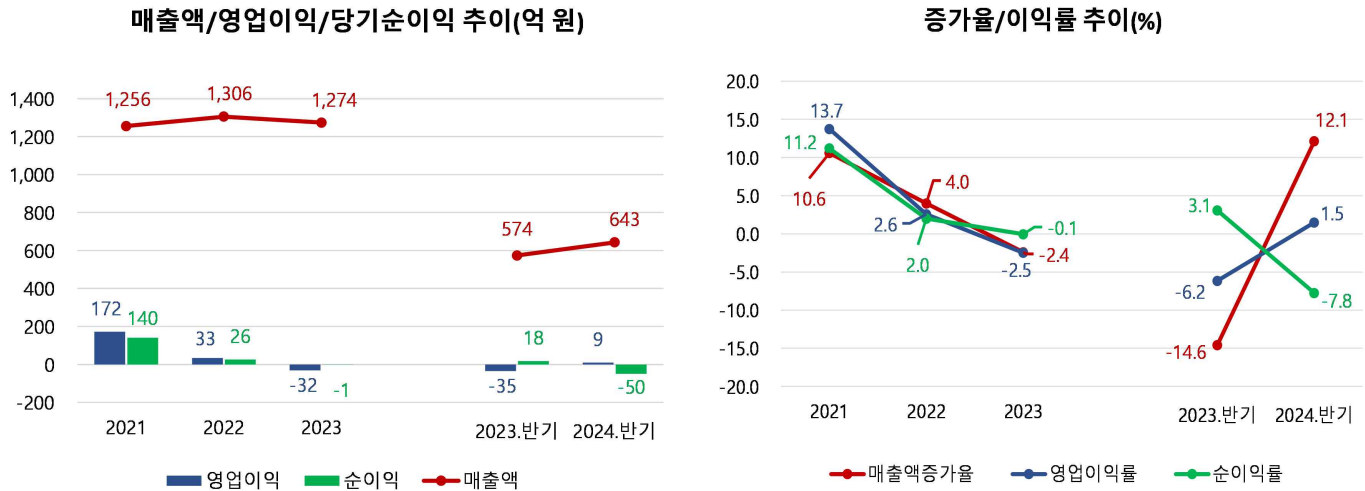
##### ■ 2024년 상반기 매출액 증가와 비용절감 노력에 힘입어 흑자전환

동사의 영업이익 규모는 2021년 172억 원으로 영업이익률 13.7%를 기록했으나, 2022년 33억 원으로 영업이익률 2.6%로 급감하였고, 2023년에는 -32억 원을 기록하면서 적자전환하였다. 2023년 영업이익 적자전환의 원인은 매출액 감소와 더불어 인건비 증가, 설비 증설에 따른 감가상각비 증가, 전자재료 사업 관련 초기 비용(연구개발비, 무상샘플 공급비용 등) 지속, B2C 사업 적자 지속 등 고정비 부담 증가 등의 영향에 기인한다. 한편, 당기순이익은 외화 파생상품 수익 발생, 법인세 환급 등 일회성 요인이 있었으나 -1억 원으로 영업적자의 영향을 벗어나지 못하였다.

2024년 상반기 영업이익은 매출액 증가와 비용 절감 노력에 힘입어 2023년 상반기 -35억 원의 적자에서 올해 9억 원의 이익을 올리며 흑자전환에 성공하였다. 계절적 영향을 받는 스마트폰 경기 특성으로 인한 매출 감소에도 불구하고 전사적인 비상경영체제 시행으로 매출원가율은 전년동기대비 5%p 감소했고 판관비율도 같은 기간 동안 3%p 감소함에 따라 수익률이 개선되었다.

그림 5. 동사 손익계산서 분석

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 반기보고서(2024.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

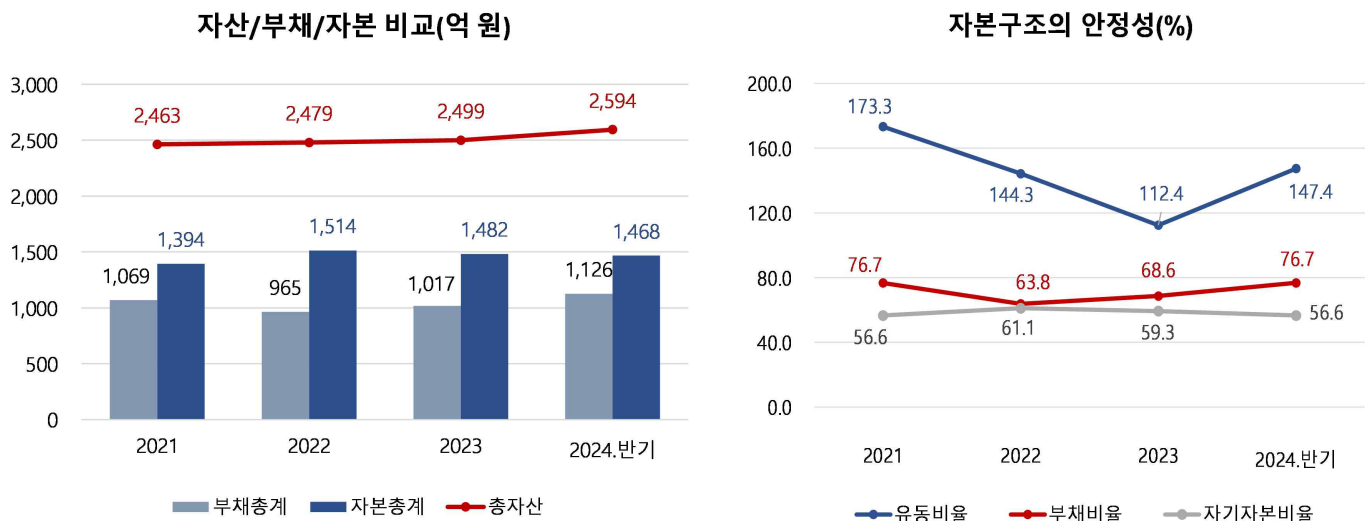
### ■ 전반적인 재무구조 양호한 수준 유지

동사의 최근 3년간 자기자본비율은 2021년 56.6%, 2022년 61.1%, 2023년 59.3%로 안정적인 수치를 꾸준히 유지해 오고 있다. 부채비율 또한 2021년 76.7%, 2022년 63.8%, 2023년 68.6%를 기록, 외부자금에 대한 의존도가 낮은 편이다. 유동성 측면에서는 2021년 173.3%였던 유동비율이 2022년 144.3%, 2023년 112.4%로 감소하고 있지만, 영업활동을 통한 현금 창출 능력이 양호한 편으로 투자 자금 소요에 큰 문제가 없으며 유동성 위험은 적은 편이다.

한편, 2024년 상반기말 현재 자기자본비율 56.6%, 부채비율 76.7%, 유동비율 147.4%로 전년 말 대비 재무안정성 지표가 소폭 개선되었으며 양호한 수준의 재무안정성을 보이고 있다.

그림 6. 동사 재무상태표 분석

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 반기보고서(2024.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

표 10. 동사 요약 재무제표

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

항목	2021	2022	2023	2023.반기	2024.반기
매출액	1,256	1,306	1,274	574	643
매출액증가율(%)	10.6	4.0	-2.4	-14.6	12.1
영업이익	172	33	-32	-35	9
영업이익률(%)	13.7	2.6	-2.5	-6.2	1.5
순이익	140	26	-1	18	-50
순이익률(%)	11.2	2.0	-0.1	3.1	-7.8
부채총계	1,069	965	1,017	1,079	1,126
자본총계	1,394	1,514	1,482	1,541	1,468
총자산	2,463	2,479	2,499	2,620	2,594
유동비율(%)	173.3	144.3	112.4	119.5	147.4
부채비율(%)	76.7	63.8	68.6	70.0	76.7
자기자본비율(%)	56.6	61.1	59.3	58.8	56.6
영업활동현금흐름	224	135	76	15	14
투자활동현금흐름	-262	-306	-260	-160	-211
재무활동현금흐름	135	10	49	169	107
기말의현금	702	531	396	559	318

자료: 동사 반기보고서(2024.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

## ■ 동사 실적 전망

동사는 PCB(인쇄회로기판), 반도체, 디스플레이 등 전자부품 제조에 사용되는 화학소재 개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 동사의 제품은 주로 삼성전기 등의 글로벌 PCB 제조사를 통하여 한국, 미국, 중국의 글로벌 전자기기 제조업체의 스마트폰, 태블릿 PC 등의 전자기기에 탑재되고 있다.

동사는 그동안 일본과 독일이 점유하고 있던 국내외 전자 화학소재 시장에서 순수 독자기술을 통한 진입에 성공해, 현재 국내에서 PCB 가공 공정에 필요한 약품 전체를 생산할 수 있는 유일한 기업으로 향후 성장성이 크게 기대된다. 2024년 매출은 주요 매출원인 최종표면처리 제품군이 현재 꾸준한 매출을 시현하는 가운데 PKG 분야에서 End-user의 최종 승인 가능성이 높아지고 있어 매출액 증가 및 수익성 개선이 전망된다.

표 11. 동사 사업부문별 연간 실적 및 전망

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

항목	2021	2022	2023	2024(E)
매출액	1,256	1,306	1,274	1,380
화학약품	1,441	1,360	1,418	1,495
기판가공	161	150	74	82
설비제조	47	58	64	67
소재유통	1	42	28	36
(연결조정)	(394)	(304)	(310)	(300)

자료: 동사 사업보고서(2023.12.) 및 동사 IR 자료(2024), 한국기술신용평가(주) 재구성

## V. 주요 변동사항 및 향후 전망

### 화학약품 사업에서 소재 및 장비 사업으로의 진출로 성장동력 확보

동사는 반도체패키지 기반 화학소재, 극동박, 5G 관련 화학소재, 디스플레이 소재 등으로 사업을 확장하고 있다. 동사는 급변하는 반도체, 전자부품 시장에 적극 대응하기 위해 기존 화학약품 사업에서 소재 및 장비 사업으로 진출하였으며, PCB 화학약품/소재/장비 토탈 솔루션 제공으로 시장을 선도하고자 한다.

#### ■ 화학약품 사업에서 화학/전자소재 및 장비 사업으로의 확대

동사는 기존의 PCB 화학약품 사업에서 소재 및 장비 사업으로 확장하여 PCB 기반 토탈 솔루션을 제공하고자 한다. 동사는 PCB 화학약품 사업을 모바일 통신 분야에서 전장, 반도체, 데이터센터 분야로 확대하였으며, 반도체패키지 기반 화학소재, 전기동도금, 극동박 사업으로 진출하였다. 또한, 동사는 소재솔루션사업부를 신설하여 전자소재 분야인 디스플레이, 웨이퍼, 접착제(수지), 그래핀 소재 부문으로 진출을 준비하고 있으며, 외국 기업이 독점하고 있는 소재에 대한 국산화와 원천 기술을 확보하고자 한다.

동사는 2024년 기준 전기동도금 약품 22종, 화학동도금 약품 39종, 회로용 약품 69종, 표면처리 약품 118종으로 총 248종의 제품군을 보유하고 있으며, 2026년 전기동도금 약품 27종, 화학동도금 약품 50종, 회로용 약품 80종, 표면처리 약품 130종으로 총 287종의 제품군을 보유할 것으로 전망된다. 또한, 2024년 기준 FPCB용 제품은 125종, HDI(High Density Interconnection)/MLB(Multi Layer Board)용 제품은 75종, 반도체패키지용 제품은 48종을 보유하고 있으며, 2026년에는 FPCB용 제품 131종, HDI/MLB용 제품은 84종, 반도체패키지용 제품은 72종으로 FPCB 분야에서 HDI/MLB/반도체패키지 사업 분야로의 확대를 준비하고 있다.

#### ■ 극동박(Ultra-thin copper foil) 개발을 통한 사업 확장

동사는 기존의 화학약품 사업에서 소재사업으로의 확장을 위해 2022년 극동박 사업에 진출하였다. 극동박은 반도체 실장기판의 원소재로 사용되는 동박으로 일본 회사의 독점 소재였으나 동사의 독자적인 기술개발로 반도체패키지 공정용  $1\mu\text{m}\sim 3\mu\text{m}$ 의 극동박을 개발하여 국내에 공급하고 있다. 극동박은 미세회로기판, FCCL(Flexible Copper Clad Laminate), 전자파 차폐 필름, 자동차 열선 소재 등 다양한 분야에 적용이 가능하여 성장 잠재력을 가지고 있다. 또한, 향후 PCB 산업에서 필수 소재로 사용될 것으로 예상하고 있으며, 경박단소화 전자부품에 대한 요구가 증대되고 있는 추세인 바 선제적으로 2023년도 4분기에 극동박 생산 인프라를 증설하였다.

동사의 극동박은 표면에 돌기가 형성되어 있는 나노투스(Nanotus) 동박으로 조밀한 크기의 돌기를 적용시켜 5G 시장에서 요구하는 신호의 전송률, 밀착력을 만족하고 있으며, 신호 손실 최소화와 회로안전성 유지가 가능한 최소한의 두께의 저조도 극동박 국산화 기술 국책과제를 진행하고 있다.



## 와이엠티(251370)

### 증권사 투자 의견 예시(하단)

작성기관	투자 의견	목표주가	작성일
-	-	-	-
투자 의견 없음			

### 시장 정보(주가 및 거래량)



자료: 네이버증권(2024.09.19.)

### 최근 6개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

#### 시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자 주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.

시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
와이엠티	X	X	X